证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-058

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币173,832,028.54元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币30,148,456.12元（包括：审计费及验资费12,467,000.00元、律师费10,904,467.37元、用于本次发行的信息披露费用4,575,471.70元、发行手续费及材料制作费等2,201,517.05元），募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZI10561号《验资报告》。

（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目	募集资金发生情况（人民币元）
2024年募集资金结余金额	523,844,590.03
减：本报告期募集资金使用金额	41,319,101.59

项目	募集资金发生情况（人民币元）
减：手续费	1,504.11
加：利息收入	1,562,379.54
募集资金结余金额	484,086,363.87

注：募集资金结余金额详情见本专项报告二、（二）及三、（四）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2021年11月，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海昌里支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司盛帷半导体设备（上海）有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年10月，公司和保荐机构海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。2024年6月，公司及全资孙公司ACM RESEARCH KOREA CO., LTD. 和保荐机构海通证券股份有限公司与KB Kookmin Bank Seongnam Hi-tech valley Branch共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。其中中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行已于2023年5月15日销户，上海银行股份有限公司浦东分行已于2023年5月22日销户，中国工商银行股份有限公司上海

自贸试验区新片区分行已于2024年8月23日销户，招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行已于2024年11月7日销户，宁波银行股份有限公司上海长宁支行已于2024年11月28日销户，中国光大银行股份有限公司上海昌里支行已于2024年12月17日销户，KB Kookmin Bank Seongnam Hi-tech valley Branch已于2025年2月21日销户。截至2025年6月30日，其他上述监管协议履行正常。

（二）募集资金存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	金额（人民币元）	备注
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121909929210918	143,153,679.39	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801900002063	50.78	活期存款
招商银行股份有限公司上海淮海支行	121909929210202	250,019,798.81	活期存款
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100156371	491,517.21	活期存款
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121938866210666	421,317.68	活期存款
合计		394,086,363.87	

注：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额 484,086,363.87 元差异 90,000,000.00 元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额，详见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年6月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。2025年6月20日，公司已将上述暂时补充流动资金的25,000.00万元归还至募集资金专用账户，该笔资金

使用期限未超过12个月。

公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行临时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。截至2025年6月30日，公司尚未实际使用闲置募集资金临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额（元）	年化收益率
兴业银行股份有限公司 上海市北支行	大额存单	2023.1.31	2026.1.31	90,000,000.00	3.15%
合计				90,000,000.00	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2025年1月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”，并将该项目拟投入募集资金24,500.00万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）变更至首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与

制造中心”。变更后，“盛美半导体设备研发与制造中心”总投资额维持156,890.00万元不变，募集资金投入金额将增加至144,500.00万元，剩余部分由公司自有资金或自筹资金补足。该事项于2025年2月11日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年6月28日披露了《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2025-047），首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”、“盛美半导体高端半导体设备研发项目”、“补充流动资金”和“高端半导体设备拓展研发项目”已完成投入或达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目全部结项。截至2025年6月30日，公司“盛美半导体设备研发与制造中心”项目尚未使用募集资金金额为186,147,030.29元，为该项目需用于支付已签订合同但未到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的质保金等款项。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年1月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”，并将该项目拟投入募集资金24,500.00万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）变更至首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”。详见公司于2025年1月11日披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。公司变更募投项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月7日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位: 盛美半导体设备(上海)股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额(注 1)				3,481,258,520.34		本年度投入募集资金总额				41,319,101.59			
变更用途的募集资金总额				245,000,000.00(注 2)		已累计投入募集资金总额				3,107,787,817.92			
变更用途的募集资金总额比例				7.04%(注 2)									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注 3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
盛美半导体设备研发与制造中心	是	700,000,000.00	1,445,000,000.00	1,445,000,000.00	41,319,101.59	1,258,852,969.71	-186,147,030.29	87.12	2025 年 6 月	(注 5)	(注 5)	否	
盛美半导体高端半导体设备研发项目(注 4)	不适用	450,000,000.00	不适用	450,000,000.00		454,587,394.44	4,587,394.44	101.02	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	不适用	650,000,000.00	不适用	650,000,000.00		650,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
高端半导体设备拓展研发项目(注 4)	不适用	730,871,500.00	不适用	730,871,500.00		744,347,453.77	13,475,953.77	101.84	不适用	不适用	不适用	否	
盛美韩国半导体设备研发与制造中心	是	245,000,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是	
合计		2,775,871,500.00		3,275,871,500.00	41,319,101.59	3,107,787,817.92	-168,083,682.08	94.87					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目的原因: 由于 2024 年上半年全球营商环境的变化, 公司经审慎评估后认为, 通过“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目对盛美韩国进行大规模固定资产投资将面临风险。2024 年 12 月 2 日公司及盛美韩国被美国工业和安全局(BIS)列入“实体清单”, 也印证了公司前期的预判。 基于上述原因, 为了更好地维护公司和股东的利益, 规避因全球营商环境变化带来的风险, 提高募集资金使用效率, 公司经过审慎研究决定终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见专项报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见专项报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	见专项报告三、（八）

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 3,481,258,520.34 元。

注 2：“变更用途的募集资金总额”是指公司于 2025 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”，并将该项目拟投入募集资金 24,500.00 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）变更至首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”。该事项于 2025 年 2 月 11 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。本处“变更用途的募集资金总额”不包括募集资金利息以及理财收益。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：项目实际投资金额超过承诺投资金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注 5：盛美半导体设备研发与制造中心于 2025 年 6 月结项，尚未实现效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2025 年半年度

编制单位: 盛美半导体设备(上海)股份有限公司

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	盛美韩国半导体设备研发与制造中心	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盛美半导体设备研发与制造中心		1,445,000,000.00	1,445,000,000.00	41,319,101.59	1,258,852,969.71	87.12	2025 年 6 月	见附表 1	见附表 1	否
合计		1,445,000,000.00	1,445,000,000.00	41,319,101.59	1,258,852,969.71	87.12				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		公司于 2025 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》, 同意公司终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”, 并将该项目拟投入募集资金 24,500.00 万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)变更至首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”。该事项于 2025 年 2 月 11 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》(公告编号: 2025-004)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目的原因: 由于 2024 年上半年全球营商环境的变化, 公司经审慎评估后认为, 通过“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目对盛美韩国进行大规模固定资产投资将面临风险。2024 年 12 月 2 日公司及盛美韩国被美国工业和安全局(BIS)列入“实体清单”, 也印证了公司前期的预判。 基于上述原因, 为了更好地维护公司和股东的利益, 规避因全球营商环境变化带来的风险, 提高募集资金使用效率, 公司经过审慎研究决定终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								